



COMMUNIQUE DE PRESSE

Rapprochement de l'Electronique Française et Phillipine

Les associations professionnelles SEIPI (Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation) et ACSIEL Alliance Electronique ont initié en septembre 2018 un rapprochement visant à établir des relations régulières entre leurs organisations respectives.

Après deux rencontres à Paris puis à Manille, les deux parties ont signé le 28 juin dernier, lors de la réunion du Comité Economique Conjoint Franco-philippin, en présence des ministres des affaires étrangères et de MEDEF International, un « Memorandum of Understanding (MoU) » pour formaliser une coopération durable, déclinée en 5 axes :

- augmenter la notoriété de chaque association dans chacun des pays,
- se doter d'avantages compétitifs et supporter des projets d'innovation sur des technologies clés,
- développer les échanges de biens et de services électroniques entre la France et les Philippines,
- favoriser les relations globales entre PME des secteurs électroniques respectifs,
- accroître les possibilités d'investissements industriels dans chaque territoire.

Les Présidents Dr. Dan Lachika (SEIPI) et Jean-Luc Estienne (ACSIEL) se sont félicités de cet accord bilatéral qui va renforcer leurs industries électroniques et la position de leurs adhérents dans leurs pays respectifs. Ils ont remercié vivement les ambassades pour leur contribution essentielle à cette nouvelle collaboration.

Dans leur relevé de conclusion, les ministres M. Lopez pour les Philippines et M. Lemoyne pour la France ont souligné l'excellent état d'esprit de cet accord, le souhait mutuel de renforcer et de développer les coopérations entre industriels et chercheurs des deux organisations ainsi que la forte volonté de coopération dans les domaines de la conception et du développement de composants électroniques en général et plus particulièrement de circuits intégrés de futures générations.

Enfin, les deux ministres n'ont pas manqué de souligner l'importance économique que représente la production locale dans la chaîne de valeur de l'électronique dans leur pays, depuis la fabrication des composants en amont, les équipements, l'assemblage et le test des cartes électroniques jusqu'à l'intégration en aval dans les systèmes chez les utilisateurs finaux.

Cet accord constitue un premier levier pour une collaboration à long terme que chaque partie espère fortement contributrice d'innovations électroniques pour un bénéfice commun.

